



立式旋转腔 PVD镀膜设备

Vertical PVD System with U Turn

特点描述

- 立式旋转腔设计，减少设备长度，减少占地面积；
- 2800mm平面阴极，大幅宽大产能设备设计；
- 智能化工艺程序管理，实时数据记录。

Features

- Vertical sputtering with U turn, footprint reduction;
- 2800 mm in length, planar cathode;
- Intelligent program management, real-time data recording.

技术性能 Performance

项目 Item	数值 Value
基板大小 Substrate	1200mm*2400mm*2.2~3.2mm
节拍 Tact time	35s
工艺速度 Process speed	40mm/s
碎片率 Breakage rate	<0.1%
无效边区域 Grip area	<5mm
片间/片内均匀度 Between/Within uniformity	<5%

技术参数 Parameter

项目 Item	数值 Value
设备尺寸 Layout	43700mm*11480mm*5200mm (含自动化Automation included)